1. Introduction 各酸化膜形成方法の特徴とデバイス適用時の問題点

|                 | 密度 | 絶縁性 | 膜厚     | 温度     | 下地              |  |
|-----------------|----|-----|--------|--------|-----------------|--|
| 熱酸化             | 高  | 高   | 任意     | 700 以上 | c-Siのみ          |  |
| オゾン酸化<br>ラジカル酸化 | 盲  | 高   | 5 nm以下 | 任意     | c-Si<br>poly-Si |  |
| CVD             | 低  | 低   | 任意     | 任意     | 任意              |  |

 $CVD-SiO_2$  膜のオゾン改質により、以下の要求を満たす酸化膜を形成する

- 1. **任意の下地上**
- 2. **任意の膜厚**
- 3. 高密度(高絶縁性)

## 予想されるCVD-SiO2膜のオゾン酸化改質の効果



## 改質(Si - Oネットワーク再構成) 下地の酸化

SiO<sub>2</sub>膜中の密度深さ分布評価が必要 ↓ X線反射率解析

### ダイナミックレンジの光源依存性



7~13 degで出現する特徴的な振動を検出する ためには,9桁以上のダイナミックレンジが必要

### 2. Experiments

(1) Sample perparation

HF etching(p-Si(100) substrate) $CVD SiO_2$ (3, 6, 10 nm) $O_3$  treatment $(\text{wet } O_3, 450 , 30 \text{ min})$ 

- (2) Meausrements
  - X-ray reflectivity (XRR) (密度,膜厚,表面ラフネス)
    Beam line : SPring-8 BL16XU(産業界専用)
    Energy : 8 keV, Cu filter

3. Results X線反射率によるCVD-SiO2のオゾン酸化改質評価



Fig. 4. XRR spectra of 10 nm thick CVD-SiO<sub>2</sub> film after O<sub>3</sub> treatment.

#### CVD (6 nm)

### $CVD (6 nm) + O_3$



Fig. 5. XRR spectra of 6 nm thick CVD-SiO<sub>2</sub> film after O<sub>3</sub> treatment.

CVD (3 nm)

 $CVD (3 nm) + O_3$ 



Fig. 6. XRR spectra of 3 nm thick CVD-SiO<sub>2</sub> film after O<sub>3</sub> treatment.



表面改質層,界面酸化層の厚さ、密度は,ベース膜厚に依存しない。

4. Discussion 表面高密度改質及び界面酸化層形成モデル



# 酸化種の拡散による表面高密度改質及び界面酸化層形成モデル



#### 5. Conclusion

オゾン酸化されたCVD-SiO2膜は、 表面側ではSi-Oネットワーク構造が再構成され高密度化 界面側では基板が酸化され 高密度/低密度/高密度の3層密度分布構造を持つ。

表面側の高密度改質層,及び界面酸化層の厚さは, ベース膜厚に依存しない。CVD-SiO2中のOの拡散長は 非常に長く,さらに厚膜でも改質効果が期待。

界面と膜中の改質が同時に可能。 オゾン酸化+CVD-SiO<sub>2</sub>積み増しでは不可能。

酸化条件による拡散長制御により, 膜全体の改質が期待 できる。